

第31回 2022 JIEPワークショップ 開催案内

デジタルトランスフォーメーションを加速させる先端実装 ～日本の半導体産業の基盤強化へ実装は何ができるか？～

発表者と徹底議論 一般参加者大募集！

招待講演、ポスター発表 33件 決定！

日時：2022年10月14日(金) 9:00～18:30

場所：かわさき新産業創造センター・AIRBIC



エレクトロニクス実装学会では、実装技術に関するワークショップを、10月14日(金)、かわさき新産業創造センター AIRBIC (神奈川県川崎市幸区) にて開催いたします。

『デジタルトランスフォーメーションを加速させる先端実装 ～日本の半導体産業の基盤強化へ実装は何ができるか？～』というテーマを掲げ、以下のような魅力的なプログラムを予定しております。

- **招待講演**： **西田 秀行 氏 (NEP Tech. S&S)**
『半導体実装技術の新たな方向を探る
＝我が国半導体の再生を願って(仮)』
- **ポスター発表 (33件)**
パワエレ・カーエレ、プロセス・接合、実装材料、評価信頼性、AI分野などから厳選

このワークショップでは、通常の講演会や学会とは異なり、ポスターの前で発表者と参加者が一体となり、双方向のディスカッションを中心に行います。対面での熱い議論の中から、課題解決へのヒントや将来の夢、新たな問題提起や異分野の方々とのネットワーク構築等々、多くの成果を必ずやお持ち帰りいただけるものと確信しております。詳細情報は、準備出来次第、学会ホームページ (<http://jiep.or.jp>) に掲載いたします。

2022ワークショップ実行委員会 委員長 滝澤 稔 (東芝デバイス&ストレージ)

申込:

[発表者の方はこちらから](#)

[発表者以外の方はこちらから](#)

参加費用: 正会員・賛助会員・シニア会員: ¥17,000、学生会員: ¥6,000、一般: ¥20,000
(資料代、昼食、第三セッション、消費税を含みます。*なお一般の方は、同時に学会にご入会いただくと、初年度のみ年会費半額で、かつ今回のワークショップに会員扱いでご参加いただけます。)

申込締切: 9月26日(月) (ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。)

定員: 100名(先着申込順)、支払方法: 銀行振込。申込後のキャンセル不可。

問合せ先: 〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2, Tel:03-5310-2010,

Email: 2022ws@jiep.or.jp

AIRBICアクセス

<https://kawasaki-sozonomori.jp/airbic/>
212-0032 川崎市幸区新川崎7-7

- J R 横須賀線・新川崎駅より徒歩 10分
- J R 南武線・鹿島田駅より徒歩 15分

スケジュール(予定)

10月14日(金)

9:00～	登録開始・ポスター準備	14:15～15:45	第2セッション(ポスター)
10:00～10:20	オープニング	16:00～17:00	招待講演(西田氏)
10:20～11:20	アブストラクトトーク	17:00～17:15	クロージング
11:20～12:30	昼食	17:15～18:30	第3セッション(意見交換)
12:30～14:00	第1セッション(ポスター)		

第1セッション (12:30-14:00)

パワーエ	1. パワー半導体実装用接合材料の基礎物性と信頼性評価法	八坂 慎一/神奈川県立産業技術総合研究所
	2. SiCパワーモジュールの225℃パワーサイクル耐量とCTE緩衝板の効果一考察	加藤 史樹/産総研
	3. パワー半導体の簡易解析モデルの検討と熱負荷の解析精度検証	佐藤 克哉/東芝
プロセス・接合技術	4. ヘテロジニアスデバイス実現に向けた高密度インクジェット実装技術	宮崎 淳志、杉本雅明/エレファンテック
	5. マイクロサイズ銀粒子ペーストへのセラミック粒子添加による接合部の耐熱性向上	淀 将悟/大阪大学大学院工学研究科
	6. 銀ペーストを進化させる銀微粒子	加藤 諒/大阪ソーダ
	7. セルロースナノファイバー含有ニッケル複合めっきの開発に向けて(仮題)	飯岡 諒/群馬大学
	8. コンフォーマル印刷法 -センサ・デバイスの次世代実装・製造技術-	野村 健一/産総研
実装材料	9. 次世代実装技術に向けたスパッタ法による耐酸化性Cu-Pdポーラス型接合材料の作製	根本 俊介/神奈川県立産業技術総合研究所
	10. バンプレス接合によるWafer-On-Wafer積層用高耐熱性樹脂の開発	新木 直子/ダイセル
	11. 銀ナノワイヤー(AgNWs)の合成とダイボンディング材への展開	熊谷 圭祐/日本スペリア社
	12. RoHS指令規制物質“フタル酸エステル”の簡易スクリーニング技術開発	小川 加奈子/東芝
信頼性	13. Sn酸化被膜に基づくはんだ付け性試験の新規前処理の検討	泉水 崇彰/TDK
	14. 高信頼性を実現するHDD向け基板の設計開発の進め方	岡野 太一/東芝デバイス&ストレージ
センシング	15. 新たな冷却加熱方式を用いた熱負荷試験中の電子基板の3次元熱変形およびサーモグラフィカメラ計測	菊池郁織/エスペック
	16. 自己放電抑制による湿度変動電池の電圧向上	駒崎 友亮/産総研
ウエアラブル	17. 銀めっき繊維を用いたファブリックスピーカー2	吉田 学/産総研

第2セッション (14:15-15:45)

パワーエ	18. エレクトロニクス分野における低誘電材料の開発 ～PEEKとその発泡体～	田中 佳典/イノアックコーポレーション
	19. ワイドバンドギャップ半導体向けパワーモジュール開発	杉木 昭雄/大分デバイステクノロジー
プロセス・接合技術・装置	20. ブルーレーザーとはんだボールを用いたフラックスレス微細接続技術	藤島 利輝/堀内電機製作所
	21. Co触媒を利用したボイドフリー最終表面処理プロセス	瀬戸 寛生/奥野製薬工業株式会社
	22. バンプの狭ピッチ化にどう対応するか ～最終表面処理とその実装信頼性～	真田 昌樹/新光電気工業
	23. ヘンダブル性を有する多層ビルドアップ基板への実装技術開発	滝沢 優哉/新光電気工業
実装材料	24. シミュレーションによる半導体封止剤の注入性評価	宮田 悟志/ダッソー・システムズ
	25. 優れた熱特性と耐薬品性を有する耐熱絶縁用途向け電着塗料の開発	田村翔/日本パーカライジング
	26. ハイブリッド接合用ウエハ接合材料	岡太 航/三井化学
	27. 耐熱性と膜厚均一性を有するハイブリッド接合向け仮固定テープ「SELFA」	星野 文香/積水化学工業
	28. 低誘電正接ポリイミドの開発(仮題)	小笠原 央/東レ
信頼性	29. MEMSプロセスを応用した微細樹脂-Si複合構造体の作製	水寄 英明/長野県工業技術総合センター
	30. 宇宙用セラミックBGAパッケージ実装サンプルにおいて熱衝撃3,500サイクルを達成したアンダーフィル材	篠崎 孝一/宇宙航空研究開発機構
センサ	31. ECMO回路にむけた血栓モニタリング用センサ	森田 伸友/産総研
	32. 超聴診器	小川 晋平/AMI
ウエアラブル	33. VR/AR向けウェアラブル電子テキスタイル実装技術	高松 誠一/東京大学